

財團法人工業技術研究院 函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號

承辦人：張瓊元

電話：03-5913509

傳真：03-5820241

E-mail：JoanneChang@itri.org.tw



108000386109

241 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 14 號 9 樓之 3

受文者：台灣區照明燈具輸出業同業公會

發文日期：中華民國 108 年 03 月 12 日

發文字號：工研材字第 1080003861 號

速別：普通件

密等：無

附件：如文

主旨：本院材料與化工研究所於 108 年 3 月 28 日(四)假工業技術研究院 77 館 101 會議室舉辦經濟部專案之 108 年產學研合作公開說明會暨 107 年成果發表會，邀請函(含議程)如附件，敬請週知會員，請查照。

說明：

1. 毫米波通訊高值關鍵材料與整合應用；
2. 工業感測器國產自主關鍵技術開發計畫；
3. AIoT 應用被動元件整合模組及其關鍵材料技術先期計畫；
4. 智慧製造系統關鍵技術開發計畫；
5. 雲端/數據中心之光互聯網計畫-矽光晶片光學封裝技術開發；
6. 綠色循環與二氧化碳新碳源創新材料計畫；
7. 智能載具動力電池系統技術開發計畫；
8. 長航時飛航載具動力關鍵技術研發暨整合應用研究計畫；
9. 先進透明顯示系統與應用技術暨服務開發計畫；
10. 面板級製程技術新應用開發計畫；
11. 高效率有機固態照明關鍵技術開發計畫；
12. 高效能地熱發電技術研發計畫；
13. 產業創新新材料開發計畫；
14. 低碳循環高功能新材料開發與應用計

照明燈具公會
收文第 108081 號
108 年 3 月 15 日 畢午

畫；15. 產業製程循環與創新應用技術開發計畫；16. 再生水資源創新膜材及系統開發與驗證；17. 民生福祉領域工業基礎技術研究計畫；18. 軟硬組織固定醫材之製程與材料開發-生醫級金屬生物陶瓷粉末配方及材料開發；19. 工研院環境建構總計畫-高值材化及智慧電子計畫；20. 複合材料智慧製造及模組開發計畫；21. 工研院創新與前瞻技術研究計畫(材化所)；等計畫。

二、地點：工業技術研究院(新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號 77 館 101 會議室)

三、費用：免費。

四、報名方式：一律採線上報名，名額有限，額滿時不再受理報名。(以報名先後順序，恕不受理現場報名。)

五、網址：

<https://wlsms.itri.org.tw/ClientSignUp/Index.aspx?ActGUID=4421AE22DB>

或進入「工業技術研究院產業學習網」→課程研討會→課程總覽：搜尋”材化所”或選擇”108 年材化所產學研合作公開說明會”→直接報名

正本受文者：台灣區電機電子工業同業公會、台灣區複合材料工業同業公會、台灣區合成樹脂及接著劑工業同業公會、台灣區人造纖維製造工業同業公會、台灣區車輛工業同業公會、台灣區機器工業同業公會、台灣區玻璃工業同業公會、台灣區模具工業同業公會、台灣區照明燈具輸出業同業公會

院長



依權責劃分規定授權業務主管決行

108 年產學研合作及 107 年技術移轉暨成果發表會

◆毫米波通訊高值關鍵材料與整合應用

- (1)108 年業界合作項目
- 高導熱低損失樹脂配方設計與製程評估
 - 導熱介面材料技術
 - 超高頻電磁波 EMI 抑制材料薄片技術
 - 高效能薄型散熱元件開發技術
 - 寬能隙晶體材料技術
 - 低介電低損失低溫共燒陶瓷構裝載板技術

- (2)107 年技術移轉項目
- 薄膜組成物專利授權
 - 銅合金散熱元件及銅合金殼體的製造方法專利授權

◆工業感測器國產自主關鍵技術開發計畫

- (1)107 年技術移轉項目
- 靜電干擾動態偵測整合技術專利授權

◆AIoT 應用被動元件整合模組及其關鍵材料技術先期計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 可塗佈式超低損耗複合材料
 - 高頻元件及其關鍵材料驗證技術
 - 高寬頻去耦電容材料技術
 - 高溫穩定型毫米波介電材料技術
 - 高導熱增層材料技術
 - 功率電感材料及元件技術
 - 液態晶圓級襯封材料及其製程驗證技術
 - 高環境耐受關鍵電容材料技術

◆智慧製造系統關鍵技術開發計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 低迴曲電子構裝多層結構優化模擬技術

◆雲端/數據中心之光互聯網計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 矽光晶片光傳輸與封裝材料技術
 - 可感光圖案化之軟性光波導材料技術

◆先進透明顯示系統與應用技術暨服務開發

- (1)108 年業界合作項目
- 高剛性透明支撐膜層技術
 - IJP 型缺陷修補層材料技術
 - 低折射透明保護上蓋板技術
 - 高阻尼透明膜層技術
 - 高韌性透明材料與成型技術

◆面板製程技術新應用開發計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 非步進式高解析光阻材料技術

(2)107 年技術移轉項目

- 大面積 Dam & Fill 封裝材料技術

◆智能載具動力電池系統技術開發計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 固態電池結構製程技術
 - 固態電池結構製程技術
 - 高容量矽碳負極材料技術
 - 高安全性膠態電解質材料技術
 - 陶瓷固態鋰電池
 - 高溫退火後高強度銅箔

(2)107 年技術移轉項目

- 雙層結構塗層製作技術
- 一種導電黏著組合物及其塗層
- 高電壓尖晶石正極材料技術
- 鋰電池模組具防延燒功能之材料與設計

◆軟硬組織固定醫材之製程與材料開發計畫

◆生醫級金屬生物陶瓷粉末配方及材料開發

- (1)108 年業界合作項目
- 生物可降解鐵基合金材料技術

◆複合材料智慧製造及模組開發計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 自動化纖維複合材料開發與應用

◆高效率有機固態照明關鍵技術開發計畫

- (1)107 年技術移轉項目
- 高效率 OLED 材料技術
 - 有機金屬化合物及包含其之有機發光裝置專利授權

◆高效能地熱發電技術研發計畫

- (1)107 年技術移轉項目
- 抗酸蝕材料與現地檢測技術

◆再生水資源創新膜材及系統開發與驗證

- (1)108 年業界合作項目
- 抗菌奈米纖維過濾膜開發技術
 - 連續式塗佈貼合製程技術
 - 離子液體模擬設計開發技術
 - 高效液體減量濃縮技術

(2)107 年技術移轉項目

- 納濾膜脫鹽優化技術

◆產業創新新材料開發計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 熱塑纖維複材製程及應用技術
 - 結構模擬分析技術
 - 破纖維紗束展纖薄化技術
 - 陶瓷異質接合技術
 - 陶瓷氫化燒結技術
 - 高強度鋁合金熔鑄與加工技術
 - 抗磨耗材料設計及塗層技術
 - 脂環族二胺氫化技術評估
 - 異質接合特用高分子開發
 - 石化/化工材料製程開發與應用評估技術
 - 高熔融強度有機/無機複合發泡材
 - 導電透光塗佈紡織品技術
 - 壓電纖維複材模組化技術
 - 高機電轉換效能壓電材料應用評估

(2)107 年技術移轉項目

- 異質接合特用高分子開發技術
- 金屬防蝕塗層快速劣化與評估技術
- 高耐久材料、配方開發與應用評估技術
- 高純樹脂純化技術
- 連續式熔融反應押出技術
- 耐侯 Nylon 工程塑膠材料技術開發
- 薄型壓電元件技術

◆低碳循環多功能新材料開發與應用計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 熱塑彈性材料補強技術
 - 多元醇改質非 VOC 生質成膜助劑
 - 生質材料珠粒發泡技術
 - 低熔點生質環保熱熔膠技術
 - 奈米消臭粉體分散液的紡織品應用技術
 - 低熱傳導塗料
 - 塑膠膜印花用四印水性藍色墨水配方技術
 - 生質機能性纖維材料技術

◆民生福祉領域工業基礎技術研究計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 流變檢測與分析技術
 - 凹版印刷用配方設計技術
 - 高均勻性電極漿料混漿製程技術
 - 羧酸酯單體連續式合成技術
 - 有機金屬觸媒合成技術
 - 高效能離子材料合成技術
 - 透明導電塗料用低順向性塗佈控制技術

(2)107 年技術移轉項目

- 有機金屬材料合成技術
- 硝基酯化合物的製備方法專利授權
- 夾片與應用其之狹縫式塗佈器專利授權

◆綠色循環與二氧化碳新碳源創新材料計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 改質型奈米金屬觸媒活化製程技術
 - 聚碳酸酯多元醇研製技術
 - 高活性奈米觸媒及純化製程技術
 - 回收樹酯合成多元醇技術
 - CO₂ 熱塑聚脂彈性體與纖維應用技術
 - 四甲基環丁烷二醇衍生應用評估
 - 聚氣酯回收應用評估
 - 耐高溫熱塑彈性體應用評估
 - 尼龍解聚再製技術
 - 材料設計快速篩選雲端服務

(2)107 年技術移轉項目

- 低溫耐衝擊之超韌耐隆開發與驗證

◆工研院環境建構總計畫-高值材化及智慧電子

- (1)108 年業界合作項目
- 智慧穿戴低溫電鏡顯像與量化技術
 - 新穎材料低電壓原子解折顯像與結構鑑定技術
 - 高電壓及高安全性膠態電解質材料技術
 - 材料熱特性分析應用技術
 - 墨水配方設計 AI 化資料建構
 - 電鍍線纜合金材料數據化
 - 導熱接著絕緣材料技術
 - 複合材料系統逆向設計演算技術
 - 高熱穩複合散熱材料特性解折與驗證平台
 - 高頻傳輸與材料特性模擬驗證技術
 - 高頻介電阻抗設計與量測整合技術
 - 毫米波 EMI 磁性量測解析技術
 - PMOLED 用光學塗料試量產技術
 - 觸媒製程與材料應用評估技術
 - 生質靛藍染料試量產技術
 - 水性 sol-gel 塗料試量產技術
 - 發光材料試量產技術
 - 分離膜相轉結構操控技術
 - 反應型材料開發技術
 - 高階光學玻璃鏡頭模塊應用之 SiC 厚膜製程技術
 - 超輕量纖維貼膜開發技術
 - FDCA 連續式氧化製程評估
 - 感壓材料與元件模組製備技術
- (2)107 年技術移轉項目
- 表面處理效能快速檢測系統
 - 電漿子光學探針技術
 - 高電壓及高安全性類固態電解質
 - 永久型抗靜電聚脂纖維技術
 - 長效型包覆性保養品複合原料技術開發

◆工研院創新與前瞻技術研究計畫(材化所)

- (1)107 年技術移轉項目
- 內埋式晶片用散熱增層材料技術
 - 高導熱抗振噪封裝材料技術
 - 長壽命高效率紅光 dopant 材料
 - 串聯式合成/純化技術開發

◆產業製程循環與創新應用技術開發計畫

- (1)108 年業界合作項目
- 遠紅外線功能陶瓷開發
 - 環保再生陶瓷黑色色料
 - 環保再生陶瓷黑磚
 - 基板樹脂降解技術製程評估
 - 廢偏光板去碘回收製程技術
 - 廢鍍液金屬離子穩定、無害化與再利用技術
 - 高純度提純與結晶核心技術
 - 鋰金屬高效率提取核心技術
 - 製程廢棄光阻再利用技術
 - 破織複材回收技術